平成 29 年９月４日

各　　位

会 社 名 平 田 機 工 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 平田　雄一郎
（コード番号：６２５８）
問合せ先　執行役員　経理部長
兼　IR・広報担当　藤本　靖博
（電話０９６－２７２－５５５８）
（URL　http://www.hirata.co.jp）

有機 EL・液晶パネル用 新型レーザーパネル切断システムの開発および販売開始について

当社は、自動車、半導体、家電などさまざまな業界に向けた多様な生産システムの製造・販売事業を世界的に展開しております。

今般、スマートフォンやタブレット用パネルの生産に必要とされる新型のレーザーパネル切断システム「HLCS-0308」を開発し、販売することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

当社は有機 EL ディスプレイ（OLED）や液晶ディスプレイ（LCD）パネルの製造装置関連も多く生産しており、それらの表示面を保護するカバーガラスに用いる強化ガラスをスマートフォンやタブレットサイズに切断するレーザー切断システムを 2012 年に開発し、生産・販売を行っております。

昨今、スマートフォンのベゼルレス化[※1]が急激に進み、スマートフォンの外形デザインに合わせた OLED や LCD パネルが必要となってきました。

これらのニーズに対応するため、当社は従来からのレーザー光学システムを発展させ、カバーガラスおよびパネルの高速切断を実現できる新型レーザーパネル切断システム「HLCS-0308」を開発・販売いたしました。本製品により、ベゼルレス化において不可欠な OLED や LCD パネルのカメラ部分やコーナー部分の加工・カット処理などを従来の研磨加工方式より高速で行えるようになりました。

また、モデル変更が著しい当該市場において製品デザインに制約を与えず、その変更への対応も当該レーザー切断方式であれば、工作機械同様にプログラマブルに対応できます。

低コストで幅広い製品デザインを実現させることができることから、国内・海外メーカーに注目されております。すでに中国の大手液晶メーカーから複数台の受注を獲得、10 月より出荷を開始する予定です。

１．新型レーザー切断機について

1）製品名、型式：「レーザーパネル切断システム」HLCS-0308 シリーズ
2）生産タクト　：2.3sec／枚～6.0sec/枚（加工内容による）
3）対応サイズ　：3.0 インチ～8.0 インチ

※ローディング・アンローディング標準装備
オプションでAOI(Automated OpticalInspection)自動光学検査を装備可能

２．価格と生産台数
標準価格：250百万円／台
生産能力：50台／年間

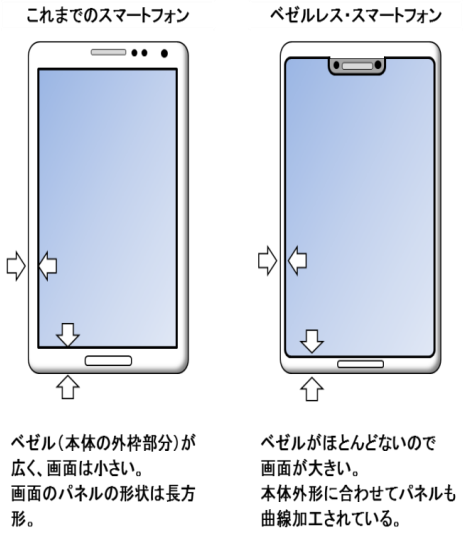
３．業績への影響
本件につきましては、今年度分は事業計画に織り込み済みであり今期の業績予想に変更はありません。

４．装置外観



５.お問い合わせ先
本製品についての詳細は以下までご連絡願います。
平田機工株式会社 事業本部 装置事業部
プロセス機器部 営業グループ 課長 風坂(ふうさか) 典正(のりまさ)
TEL：096-272-3352、E-mail：fpd@hirata.co.jp

注記
※1　ベゼルレス化(＝狭額縁)　スマートフォンの外枠部分を可能な限り狭くすること。



以上